

E

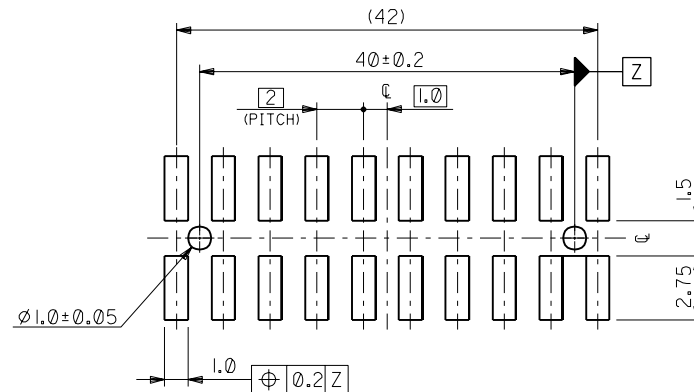
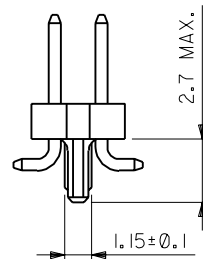
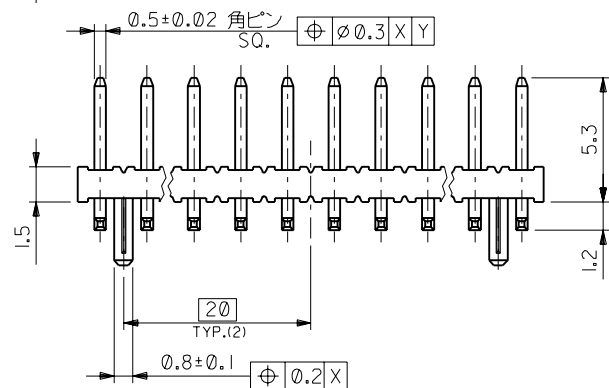
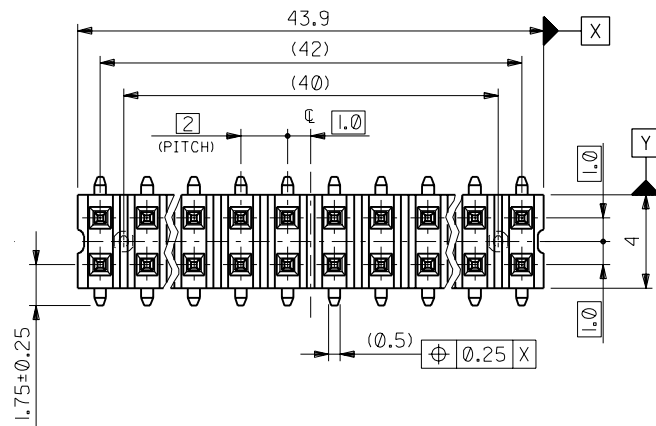
D

C

B

A

:MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

注記
NOTES

- 材質
MATERIAL
ハウジング: 耐熱性ナイロン、UL94V-0、黒
HOUSING: HIGH TEMP NYLON、UL94V-0、COLOR - BLACK
ピン: 焼青銅 (510) の0.5mm角ピン
PIN: 0.5mm SQ. PHOSPHOR BRONZE 510
- メッキ仕様
PLATING
接点部: 金メッキ0.38 μmMIN.
CONTACT AREA: GOLD 0.38 μmMIN.
半田付け部: 半田メッキ1.9 μmMIN.
SOLDER TAIL AREA: TIN-LEAD 1.9 μmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ1.27 μmMIN.
UNDER-PLATING: NICKEL 1.27 μmMIN.
- 推奨基板厚
RECOMMENDED PCB THICKNESS
1.6±0.1mm MIN.
- テールの平坦度
TAIL COPLANARITY
テールの平坦度は0.15MAX.とする。
TAIL COPLANARITY TO BE 0.15MAX.

角度 ANGLE		±3°	材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社
30°以上 OVER		±0.3	仕上げ FINISH		注記参照 SEE NOTES	
10°以上 OVER	30°未満 UNDER	±0.25	適用電線範囲 WIRE RANGE		—	
10°未満 UNDER		±0.2	被覆外径 INS. RANGE		—	
一般公差 GENERAL TOLERANCES			DRAWN BY CHK'D BY		5-1	
記号 LTR		0	新規作成 RELEASED		(T40043)	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
変更内容 REVISION RECORD			DR. CHK.		DATE	
尺度 SCALE			DWG. NO.		SD-87267-4450	REV 0